

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปั๊มนา

สปั๊ตเทอริ่ง (sputtering) เป็นวิธีการทางด้านฟิสิกส์ที่มีความสำคัญมากวิธีการหนึ่งในการเคลือบฟิล์มบางภายใต้ระบบสูญญากาศ ซึ่งเป็นวิธีการที่อาศัยหลักการพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ของพลาสม่า โดยเริ่มต้นมาจากวิธีดีซีไดโอดสปั๊ตเทอริ่ง (dc diode sputtering) ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นวิธีดีซีแมกนิตรอนสปั๊ตเทอริ่ง (dc magnetron sputtering) [1] ซึ่งสามารถแม่เหล็กในดีซีแมกนิตรอนสปั๊ตเทอริ่งจะมีผลทำให้อัตราในการเคลือบฟิล์มบางมีค่าสูงกว่าวิธีดีซีไดโอดสปั๊ตเทอริ่ง [2] จึงเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยและในอุตสาหกรรม การเคลือบฟิล์มบางในระบบสูญญากาศ [1] ซึ่งมักต้องการให้ฟิล์มบางที่เคลือบมีคุณภาพสูงขึ้นในแต่ละความต้องการที่แตกต่างกัน [3] อาทิเช่น ความแข็งของฟิล์มบางที่เคลือบ การเคลือบเพื่อป้องกันการสึกกร่อน เคลือบเพื่อให้มีสมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ เคลือบเพื่อลดการกัดกร่อน เคลือบเพื่อความสวยงาม และเคลือบเพื่อคุณสมบัติทางแสงโดยเฉพาะหรือเคลือบเพื่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งจากคุณสมบัติเหล่านี้ได้นำไปใช้จนประสบความสำเร็จในงานอุตสาหกรรมต่างๆตามความเหมาะสม และจากความแตกต่างกันของเงื่อนไขในการเคลือบเพื่อให้คุณสมบัติของฟิล์มมีผลดีที่สุด จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเข้าใจการทำงานของแหล่งกำเนิดรวมไปถึงการออกแบบแหล่งกำเนิดให้เหมาะสมกับเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อให้ได้ฟิล์มบางที่เกิดจากการสปั๊ตเทอริ่งมีคุณสมบัติตามความต้องการ [1]

หัวแมกนิตรอน (magnetron head) ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดพลาสม่าเพื่อใช้ในวิธีการสปั๊ตเทอริ่งกันอย่างแพร่หลายสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง โดยลักษณะของหัวแมกนิตรอนนั้นมีรูปทรงทางเรขาคณิตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการออกแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในแต่ละความต้องการ อาทิเช่น แมกนิตรอนทรงกระบอก (cylindrical magnetron) [4] แมกนิตรอนทรงกลมแนวราบ (circular planar magnetron) [4] แมกนิตรอนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) [4] แมกนิตรอนทรงกรวย (conical magnetron) [4] และเป็นสปั๊ตเทอริ่ง (sputter gun) [5]

สำหรับการพัฒนาของระบบดีซีแมกนิตรอนสปีตเทอริง ในกระบวนการคุณภาพของการได้มาของพิล์มบางตัวใหม่ที่มีคุณสมบัติดีกว่าเดิมนั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดของพารามิเตอร์ของพลาสma คือ ความหนาแน่นของพลาสma อุณหภูมิของอิเล็กตรอน ศักย์ของพลาสma และศักย์ลอย (floating potential) โดยหัววัดกลางมัวร์ (Langmuir probe) เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการประเมินค่าตัวแปรเหล่านี้ [6-9]

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบสร้างและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปีตเทอริง โดยต้องการออกแบบและพัฒนาให้หัวดีซีแมกนิตรอนสปีตเทอริงที่สร้างขึ้นมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกขนาดเล็กโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศและใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ และมีคุณภาพทัดเทียมกับหัวแมกนิตรอนที่ออกแบบสร้างจากต่างประเทศ และยังต้องการพัฒนาการออกแบบวัสดุที่ใช้ในการสร้างหัวแมกนิตรอนให้มีขนาดเล็กและราคาถูกเหมาะสมกับงานวิจัยที่ใช้เคลือบพิล์มบางของโลหะลงบนชิ้นงานขนาดเล็กโดยจะกล่าวถึงในบทที่ 3 และสามารถใช้ได้ในงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับผู้ประกอบการที่มีต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากนักแต่มีความสนใจในงานอุตสาหกรรมด้านนี้

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของพลาสma ที่เกิดขึ้นในระบบดีซีแมกนิตรอนสปีตเทอริงที่สร้างขึ้นด้วยการใช้หัววัดกลางมัวร์ เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ของพลาสma ที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของพิล์ม และได้ทำการทดสอบระบบดีซีแมกนิตรอนสปีตเทอริงที่สร้างขึ้นด้วยการเคลือบพิล์มบางของโลหะ เช่น พิล์มบางของทองแดง และเงิน และทำการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของพิล์มบางที่เคลือบได้โดยการใช้วิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการจัดเรียงตัวของผลึกและลักษณะโครงสร้างของพิล์มบาง และใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว และขนาดของกราน (grain)

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ออกแบบสร้างระบบดีซีแมกนิตรอนสปีตเทอริง และออกแบบสร้างและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปีตเทอริง
2. เคลือบพิล์มบางด้วยหัวดีซีแมกนิตรอนสปีตเทอริง และตรวจสอบสมบัติทางด้านฟิสิกส์ของพิล์มบางโดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ และโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริงเพื่อใช้ในการเคลือบฟิล์มบาง
2. ได้รับความรู้และทักษะด้านต่างๆในการสร้างระบบดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริง และการสร้างหัวดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริง
3. ได้รับความรู้และทักษะด้านต่างๆในการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของหัวดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริง การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของพลาสม่า การเคลือบฟิล์มบางของโลหะ และการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์ของฟิล์มบางที่เคลือบ

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1. ศึกษางานวิจัย หลักการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและใช้โปรแกรมออกแบบอุปกรณ์
3. ออกแบบระบบดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริง และหัวดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริง
4. สร้างระบบดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริง
 - 4.1 ทำหัวดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริง
 - 4.2 วัดลักษณะเฉพาะของความเข้มสนามแม่เหล็กที่ผิวเป้าของหัวดีซีเมกนิตรอนสปีตเทอริง
 - 4.3 วัดลักษณะเฉพาะของพลาสม่าโดยหัววัดกลางม้วร์
5. ทดสอบระบบโดยการเคลือบฟิล์มบางของโลหะ
6. ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่เคลือบ
7. สรุปผลและเขียนวิทยานิพนธ์

1.5 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท ซึ่งประกอบด้วย

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา และขั้นตอนการวิจัย

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่มีความสำคัญเกี่ยวกับระบบดีซีเมกนิตรอนสปัตเทอเริง ได้แก่ การโกล์ดิสชาร์จ วิธีสปัตเทอเริง หัวดีซีเมกนิตรอนสปัตเทอเริง การศึกษาลักษณะเฉพาะของพลาสม่า และการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของฟิล์มบางด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบและการสร้างระบบดีซีเมกนิตรอนสปัตเทอเริงและหัวดีซีเมกนิตรอนสปัตเทอเริง ลักษณะเฉพาะของความเข้มสนามแม่เหล็กที่ผิวเป้าของหัวดีซีเมกนิตรอนสปัตเทอเริง

บทที่ 4 กล่าวถึงวิธีการทดลอง ผลการทดลอง และการอภิปรายผลการทดลอง โดยการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของกระแสและความต่างศักย์ของการดิสชาร์จจากหัวเมกนิตรอน การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของพลาสม่าที่เกิดขึ้นจากการดีซีเมกนิตรอนสปัตเทอเริง และการศึกษาคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์ของฟิล์มบางที่เคลือบໄได โดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์และการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

บทที่ 5 บทสรุป ประยุกต์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะ

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**